

平成 15 年 10 月 28 日

各 位

アジアパシフィックシステム総研 株式会社  
本 社 : 東京都豊島区目白一丁目 4 番 2 5 号  
代 表 者 : 代表取締役社長 木 庭 清

## 機器認証システム共同開発に関するお知らせ

アジアパシフィックシステム総研は、DDIポケットと共同で  
次世代を担う機器認証システムを開発いたしました。

アジアパシフィックシステム総研株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:木庭清 以下、ASPAC)とDDIポケット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山下孟男 以下、DDI-P)は、DDI-Pが提唱する接続機器の機種情報の取得、認証が可能となる機器認証システムを共同開発いたしました。この機能により各機器の特性に合わせた適切な料金を設定することが可能となります。また、今後の各種情報家電への搭載を見据え、接続機器用の専用モジュールはソフトウェアサイズが小さく、かつ、マルチプラットフォーム対応の設計となっています。

本システムをサービス提供事業者としてソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(以下、SCN)と、情報機器メーカーとしてシャープ株式会社(以下、シャープ)へライセンス提供を行います。

SCNのSo-netが定額制データ通信サービスbitWarp(ビットワープ)に特定機器向け料金を新設し、シャープが年内発売予定の次期ザウルスに搭載し、月額2,000円程度で使い放題として提供する予定となっております。

なお、本発表による平成16年3月期の業績見通しの修正はありません。

以 上